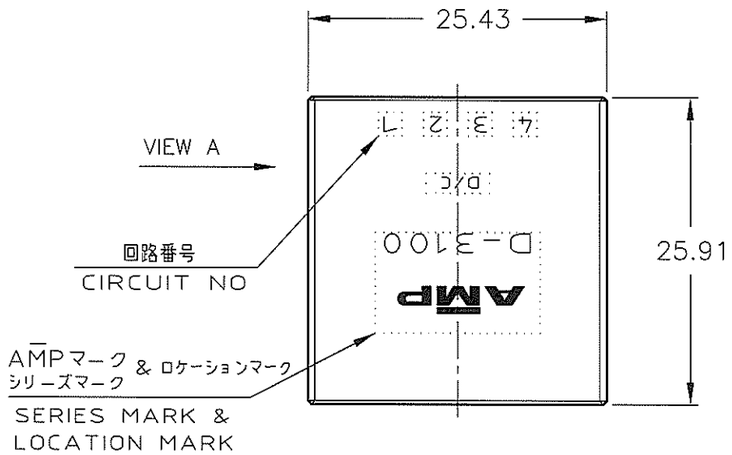
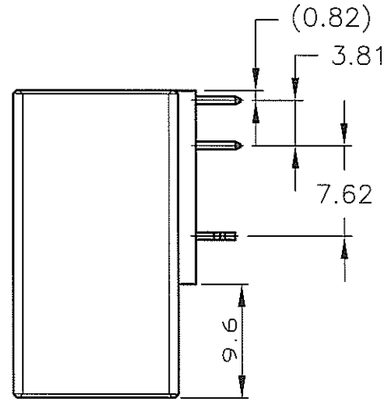
NUMBER 1717412

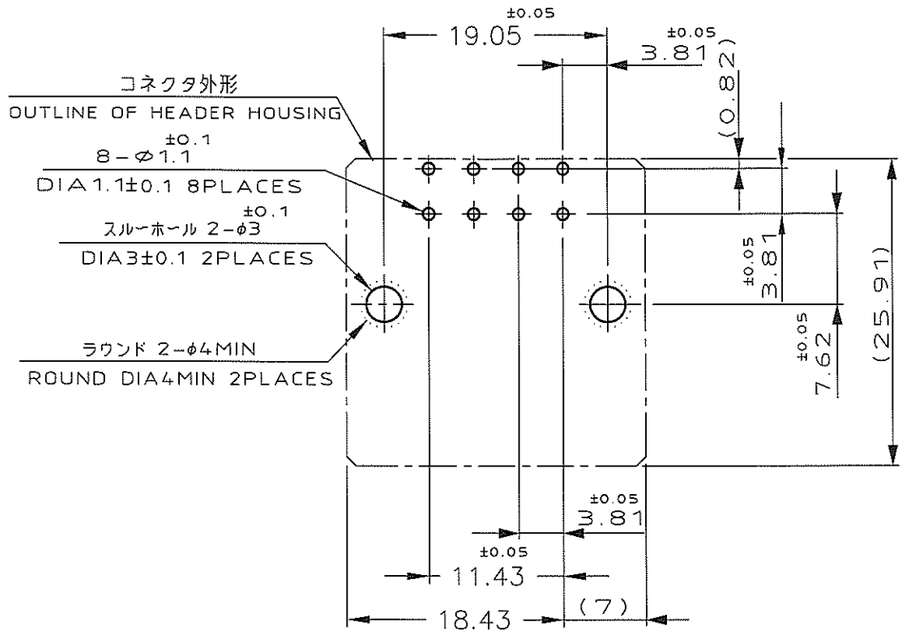
3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT





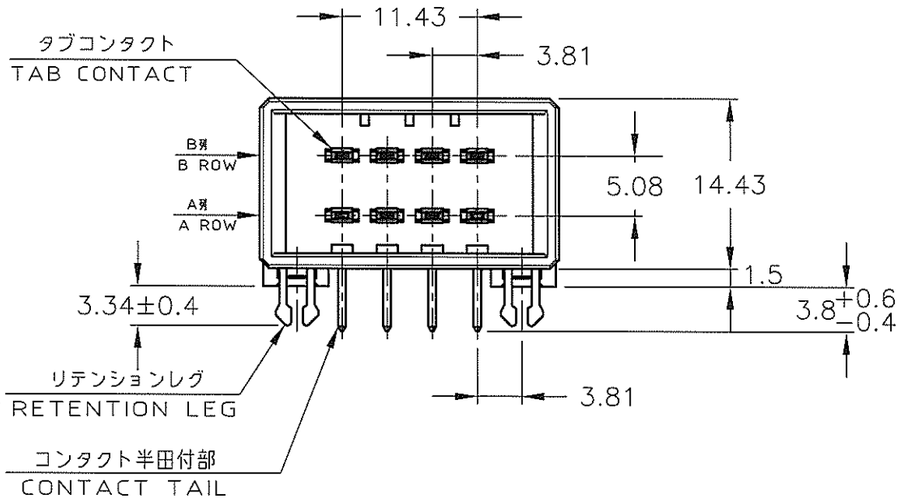


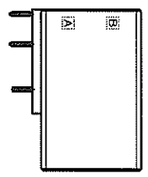
推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚:1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)





VIEW A
(SCALE:1:1)

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY

2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL

5. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

6. THE SHAPE,SIZE AND POSITION OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE THEY DON'T SHOW DETAILS

注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金

2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部:0.38μm MIN金めっき

3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部:0.76μm MIN金めっき

4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部:2.0 μm MINスズめっき

5. めっき リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき

6. 文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、詳細を示すものではありません

5	3	1717412-3
5	4	1717412-5
5	2	1717412-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
A	ADD P/N ECR-07-021778	Y.Y	D.M	19SEP 2007
02	REVISED ECR-07-013273	T.S	D.M	11JUN 2007
01	ADD P/No ECR-06-003503	T.S	S.M	20FEB '06
0	RELEASED FJD0-0292-03	T.S	S.M	29AUG '03

Copyright © 1991
AMP(Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

Tyco Electronics — Tyco Electronics Corporation, Kawasaki, Japan

WIRE RANGE	mm²(AWG -)
INSULATION DIA	- mmφ
MATERIAL	SEE NOTE 注記参照
FINISH	SEE NOTE 注記参照
DR.	T.Sakamoto 29.AUG '03
DE.	
CHK	D.Mitsugi 29.AUG '03
APP.	S.Manabe 29 AUG '03

NAME ダイナミックD3100 水平タイプ 8 極 ヘッダーアセンブリー
8 POS DOUBLE ROW
HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100

一般公差 (GENERAL TOLERANCE): 10以下 ±0.3; 10を超え30以下 ±0.4; 30を超え100以下 ±0.45; 角度 ±3°

SIZE	LOC	NUMBER
A3	J	C-1717412

SCALE	REV.	SHEET
2-1	A	1 OF 1

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/'83

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面